# 經濟部 110 年度 臺灣資安卓越深耕-半導體及資通訊供應鏈資安關鍵技術發展 計畫 合作研究計畫

《供應鏈資安個案研究與政策規範產業推廣》 建議書徵求文件

財團法人資訊工業策進會

中華民國 110 年 3 月 30 日

# 110年度合作研究計畫建議書徵求文件

## 一、簡介

為透過與產業組織的合作研究,使國際供應鏈資安觀測研析之成果能落實於半導體產業,使半導體產業與國際供應鏈資安規範接軌,協助主計畫共同進行國際供應鏈之合規暨個案研究分析,使廠商在產品設計開發階段即將國際資安規範納入考量,以降低廠商資安風險及合規成本。

背景:國際大廠要求台灣半導體供應鏈廠商符合國際安全規範,我國半導體產業供 應鏈廠商必須採取相對應的措施,以符合國際供應鏈資安規範。

動機:透過與產業組織的合作研究,協助主計畫共同進行國際供應鏈之合規暨個案 研究分析,使廠商在產品設計開發階段即將國際資安規範納入考量,以降低 廠商接軌國際供應鏈之合規相關成本。

目的:以半導體上、中游產業供應鏈為範圍,協助半導體企業進行接軌國際供應鏈 之合規暨個案研究分析,並產出分析報告。

重要性:結合公協會專業能力與組織運作經驗,使國際供應鏈資安觀測研析之成果 能落實於半導體產業。

### 二、計畫目標

以半導體上、中游產業供應鏈為範圍,完成半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨 個案研究分析,並產出分析報告。

# 三、計畫範圍

- 1. 半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析 以半導體上、中游產業供應鏈為範圍,完成5家半導體企業進行接軌國際供應鏈 之合規暨個案研究分析,並產出分析報告。
- 2. 半導體產業聚落資安合規分析

應用國際供應鏈資安檢核表,調查我國半導體產業聚落資安合規情形,並分析各聚落資安合規優勢與弱勢。

### 四、預期成果(明確說明合作研究成果之產出)

#### 預期成果包含:

1. 半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析:

以半導體上、中游產業供應鏈為範圍,促成5家半導體企業進行接軌國際供應鏈之個案研究分析,並產出分析報告。

2. 半導體產業聚落資安合規分析

應用主計畫提供之國際供應鏈資安檢核表,調查至少20家半導體廠商資安合規 情形,依據廠商類別分析各聚落資安合規優勢與弱勢,並產出分析報告。

※前述成果如有專利構想或專利申請產出時,需注意專利申請之新穎性(novelty)。因凡經公開發表之研發成果,如擬申請專利,須於公開發表後6個月內完成,前述成果如是以論文方式公開發表,將無法取得大陸與歐盟等國之專利。

### 五、 執行方式(包括計畫時程、計畫分工方式)

110年5月31日前:以本會提供之專家問卷完成調查至少20家半導體廠商資安合規情形,依據廠商類別分析各聚落資安合規優勢與弱勢。

110年9月15日前:以本會提供之訪綱完成5家半導體企業接軌國際供應鏈之個案研究,內容包含但不限於該企業之產品、服務、流程與其供應鏈上下游相關資訊。

## 六、 計畫期程及預估計畫總經費

計畫執行區間: 110 年 4 月 1 日 至 110 年 11 月 30 日

總經費:300,000元

# 七、 驗收標準(含教育訓練)

110年5月31日:完成調查至少20家半導體廠商資安合規情形,依據廠商類別分析各 聚落資安合規優勢與弱勢,並產出1份「半導體廠商資安合規分析報 告」。

110年9月15日:完成5家半導體企業接軌國際供應鏈之個案研究,內容包含但不限於該企業之產品、服務、流程與其供應鏈上下游相關資訊,並產出1份「半導體企業接軌國際供應鏈之個案研究分析報告」。

# 八、 技術能力需求(請詳述所需要之技術能力或專長)

- 1. 熟悉我國半導體產業供應鏈上下游廠商產品、服務、流程相關資訊。
- 2. 具備半導體供應鏈之資安合規分析相關經驗。